

tML[®] - Teilfrontplatte 5TE mit 12x MPO Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 3HE schwarz



tML[®] 24

tML[®] 24 ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP[®]24 Faser - und Telco-Steckverbinder, über die zwölf bzw. sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR8 derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML[®]-Verkabelungssystem als bewährtes tML[®] Standard - System sowie in den hoch innovativen Varianten tML[®] Xtended sowie neu als tML[®] 32 - System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Die tML[®]- LWL Teilfrontplatte MPO/MTP[®] ist für den Einbau im 3HE tML[®] - Modulträger vorgesehen.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tML[®] - Teilfrontplatte 5TE mit 12x MPO Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 3HE schwarz

Technische Daten

| | |
|------------|--|
| Bestückung | 12 x MPO/MTP [®] Adapter (grau) |
| | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |

tML[®] - Teilfrontplatten 5TE

| | |
|-------------|---------|
| Frontplatte | Schwarz |
|-------------|---------|

LWL Adapter

| | |
|--------------|--------------------------|
| Typ | MPO/MTP [®] |
| Anwendung | Multimode OM1/OM2 |
| Bauform | ohne Flansch |
| Einbauform | SC Simplex |
| Orientierung | Typ B, Key up/up |
| Farbe | Grau |
| Material | Kunststoff |
| Hülse | -- |
| Klappe | -- |
| Standards | IEC 61754-7 TIA 604-5 |
| Hersteller | US Conec |

Artikelvarianten & Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------|--|
| TML-T12MP-GRS | tML [®] - Teilfrontplatte 5TE mit 12x MPO Typ B (Key Up/Up) für Modulträger 3HE schwarz |
| TML-T12MP-TKS | tML [®] - Teilfrontplatte 5TE mit 12x MPO Typ A (Key Up/Down) OM3 Aqua für Modulträger 3HE schwarz |
| TML-T12MP-VIS | tML [®] - Teilfrontplatte 5TE mit 12x MPO Typ A (Key Up/Down) OM4 Magenta für Modulträger 3HE schwarz |